

次世代パワー半導体【SiC（炭化ケイ素）】は次世代自動車EV、航空機、医療機器等幅広い分野での利用が期待される新素材である。刃物切削できない新素材を電気により切削可能とさせたEDM（新型放電）加工機を設備導入し新分野での売上増に挑む。

新素材加工 # 放電加工 # 次世代自動車 # 金型 # 航空・宇宙産業

EDM（新型放電加工機）導入による
次世代素材加工への挑戦

現状

生産用機械器具製造業

創業より40年、精密部品加工や小物溶接、大型製缶品製作等に取り組んできた。加工サービスの提供先の多くは半導体関連であり、コロナ禍のサプライチェーンの影響等で大きな打撃を受けたところ。

一方、脱炭素社会を目指す世界的な風潮を背景にガソリン車から次世代自動車への転換が進んできており、耐久性がありながら軽量化を実現する部品加工ニーズが一層高まっている。

成長イメージ

生産用機械器具製造業

各種放電加工機（EDM）を導入し、需要が拡大する次世代自動車部品等に用いられる新素材加工に新たに挑戦する。具体的には次世代パワー半導体SiCや超硬合金を含む新素材の放電加工や金型（新分野）製造の加工サービス等を提供し、売上の安定確保や半導体関連への依存脱却、新素材加工内製化による低収益体質の脱却、さらに航空・宇宙産業への参入も目指していく。



放電加工機



熟練作業員による溶接作業

VOICE

次世代を担う従業員の手で新たな収益源を確保するよう再構築することは必要と思っていたところであった。これを契機に、将来は航空・宇宙産業等への新規需要獲得も目指したい。

POINT

申請書の作成においては、ものづくり特有の難しい技術・言葉使いは避け分かりやすく、かつ見栄えだけではなく思いが伝わるような文章作成を心がけた。

会社概要

代表者：代表取締役 三笠 征男 / 住所：福岡県筑紫野市西小田298-5

資本金：8,000万円 / 従業員数：25人 / TEL：092-926-1136

Mail：nagano@mikasa-tech.jp HP：https://www.mikasa-tech.jp/